

合肥新汇成微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2023年5月）

编号：2023-004

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	华安基金、平安基金、工银瑞信、易方达、宝盈基金、西部利得、申万菱信、大成基金、国泰基金、弘毅远方基金、中信资管、招商资管、光大资管、广发资管、太平养老保险、平安养老保险、太平洋保险、兴合基金、华泰保兴基金、永赢基金、国寿安保基金、上海宝弘资产、东方红资管、路博迈基金、百济投资、勤辰私募基金、招商证券、国金证券、申万宏源证券、国泰君安证券、华创证券、华安证券。
活动时间	2023年5月1日—2023年5月31日
活动地点	公司会议室、线上会议系统
上市公司接待 人员姓名	副总经理林文浩、董事会秘书奚颢、财务总监闫柳、证券事务代表王赞
投资者关系活动主 要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、问:相较于其他芯片领域,当前显示驱动芯片领域景气度恢复较快,是由于终端消费市场需求复苏还是下游客户补库存?这一趋势是否具备持续性?</p> <p style="text-align: center;">答:封测属于显示驱动芯片(DDIC)的中间代工环节,在整体消费电子产业链中处于相对上游的位置,终端消费</p>

市场的需求波动、显示面板及 DDIC 库存变化传导至封测环节具备一定的滞后性，因此公司难以直接判断 DDIC 景气度提升的主要影响因素。

从中长期趋势来看，中国大陆是主要的消费电子终端市场，中国大陆显示面板行业已形成显著的领先优势，进而导致上游显示驱动芯片产业链整体呈现由韩国、中国台湾逐步向中国大陆转移的趋势，集创北方、新相微等中国大陆 DDIC 设计公司迅速崛起，本土晶圆厂 DDIC 产能快速扩充。同时，受近年来国际贸易环境复杂多变影响，境外设计公司出于供应链安全的考虑，倾向于将代工端特别是封测环节转移至中国大陆。受益于产业转移的时代趋势，公司对于订单及市场份额的持续提升具备信心，消费市场的周期波动不会对中国大陆显示驱动产业链的中长期发展趋势带来重大不利影响。

2、问:关于产业转移趋势，台系 DDIC 设计公司为何倾向于将封测业务转移至中国大陆而非在中国台湾封测？

答:在技术水平、产品良率等方面，包括公司在内的中国大陆主要 DDIC 封测厂商与中国台湾厂商较为接近，能够满足客户的封测服务需求。

中国大陆是全球最大的消费电子终端市场，且京东方等为代表的企业在显示面板领域具备领先优势和规模优势，显示驱动芯片产业链整体向中国大陆转移已成为趋势。出于供应链安全等考虑，台系设计公司有动力将制造代工端整体向中国大陆转移，特别是考虑到向面板厂出货的便利性，封测端的产业转移趋势更为显著。

3、问：关于产品结构变化，OLED 相较于传统产品的价格情况如何？当前 OLED 的营收占比情况如何？

答：OLED 相较于 TDDI、DDIC 等产品主要在测试环节的要求较高，对测试平台和测试时长均有着相对更高的要求，相应导致测试环节的加工价格提升。

受益于 OLED 在终端消费市场的渗透率持续提升，以及产业转移效应影响，预计 OLED 业务的营收占比将持续攀升。

4、问：公司 Q1 毛利率水平同比有所下降，毛利率下降的主要原因是？预计后续变化趋势如何？

答：2022 年下半年起受终端消费场景气度下行影响，公司订单量有所减少，稼动率较 2022 年上半年有所下降，今年 Q1 整体上延续了 2022 年末的趋势，叠加部分客户价格折让因素，造成 Q1 毛利率同比下降。

自 2023 年 3 月起订单情况有所转暖，稼动率快速回升，预计毛利率水平将有所恢复，具体请参见公司后续公告及定期报告。

5、问：公司前五大客户情况？境内及境外客户占比及变化趋势？

答：公司前五大客户包括联咏、天钰、集创北方等，具体可参见公司招股书及定期报告。集创北方、爱协生、云英谷等境内客户的占比正持续提升。

6、问：公司当前在手订单及客户下单趋势如何？订单能见度大概多久？是否存在因下游景气度变化导致的砍单风险？

答：自 2023 年 3 月起客户订单情况显著恢复，Q2 内订单及稼动率水平整体维持在高位。

订单能见度一般为 2-3 个月，因景气度变化可能会推迟

部分订单的执行，但砍单的风险相对较小。

7、公司所封测的晶圆主要来源于哪些晶圆厂？其中来自晶合集成的晶圆占比有多少？公司产能规划是否跟随晶集成？

答：晶圆主要来自晶集成、SMIC、TSMC、联电、世界先进、和舰等晶圆厂，其中晶合集成的晶圆约占七成左右。晶合集成的扩产规划对公司有一定参考作用，但公司产能规划主要基于客户需求及订单情况，并非完全跟随产业链其他公司的扩产节奏。

8、问：相较于其他类型芯片的封测业务，DDIC 封测毛利率较高，国内其他大型封测厂商会不会进入 DDIC 封测领域挤压公司市场份额？

答：在技术端，DDIC 封测主要以金凸块制造为核心，客户对良率和稳定性有较高要求，具备相对较高的技术门槛；在资产端，DDIC 封测属于重资产投入的行业；在客户端，下游设计公司的市场集中度较高，客户黏性较强，新进的封测厂商需要通过较长周期的客户验证，因此整体而言 DDIC 封测业务具备相对较高的行业壁垒。

公司自 2011 年起从事 DDIC 封测业务，已与业内主要设计公司建立稳定良好的合作关系，主要经营基地紧邻晶圆厂和面板厂，在 DDIC 封测领域具备相对较强的先发优势和竞争优势。

同时，鉴于前述产业转移的行业趋势，中国大陆 DDIC 封测市场处于持续增长阶段，若当前业内头部厂商无法满足客户持续增长的产能需求，不排除其他厂商或新进者填补市场份额，形成多家封测厂商良性竞争的格局。

9、问：公司接受客户认证稽核主要是设计公司认证还

	<p>是面板和终端品牌认证？</p> <p>答：主要是直接客户设计公司对公司进行认证稽核，面板厂甚至终端品牌方也会根据其品控及供应链管理需要对公司进行认证。</p> <p>10、问：为什么 DDIC 使用金凸块，其他芯片比较少有使用金的？</p> <p>答：DDIC 直接应用于显示面板，面板相较于 IC 的价值较高，因此对于 DDIC 的良率和稳定性较高要求。</p> <p>金具备出色的导电性、机械加工性以及散热性能，可以起到界面之间的电气互联和应力缓冲的作用，因此 DDIC 业内基于多年实践探索形成以金凸块制程为主流。</p>
附件清单（如有）	无
上传日期	2023 年 5 月 31 日